

今週の話 韓国の財閥

韓国の企業とビジネスをしていると、必ず遭遇するのが財閥系列の問題です。これはあらゆる主要産業に関与していますが、エレクトロニクス業界では三星グループとLGグループが有名です。（かつてはこれに現代グループがいましたが、ハイニックス社が破綻してからは、マイナーになってしまいました。）両グループとも傘下に家電、オーディオ、コンピュータ、ディスプレイ、半導体、パッケージ、化学材料、プリント基板、部品など主要なメーカーを抱えており、グループ内でほとんどの部品材料を調達できる体制にあります。両グループの頂点に立つ、三星電子とLG電子は国内の市場はもとより、世界の民生エレクトロニクス市場で熾烈な競争を行っています。少し前までは、三星電子の独走のイメージが強かったのですが、この2、3年LGグループの追撃はめざましく、多くの分野で追いつきつつあります。

かつては日本でも大手の財閥系グループが、主要産業を席卷していた時代がありました。財閥グループによって多少違いはあるものの、グループ内の結束はかたく、部品材料メーカーがいずれかのグループに属していれば、競合グループへの販売は考えられませんでした。そのかわり、グループ内の需要は優先的に受注することができました。ご存知のとおり、日本では財閥グループの頂点に立つ銀行が、90年代のバブル崩壊のために、大同合併を繰り返し、財閥グループなどこだわってられない状況になってきています。

韓国の財閥グループは、かつての日本のそれよりもはるかに堅い結束で結ばれて（縛られて？）いるようです。少なくとも三星グループかLGグループのいずれかに主要な部材を納入していれば、もう一方のグループでのビジネスはほとんど期待できません。これは韓国国内のメーカーばかりでなく、海外の企業でも同じです。最近外国企業が、韓国大手財閥系企業と合併事業を立ち上げるようなニュースがでますが、これは逆に他の財閥グループのビジネスをあきらめることを意味しています。私自身多くの韓国のエレクトロニクス関連企業とはおつきあいがありますが、何らかのコミュニケーションをするに際して、財閥グループとの関係はかなり気をつかいます。

このように書いてくると、財閥グループには弊害ばかりがあるように聞こえますが、一方で財閥グループ間の熾烈な競争が、韓国のエレクトロニクス産業を世界のトップレベルまで引き上げる原動力になっていることも事実です。財閥グループ内での管理がしっかりしていれば、各企業は事業効率を高めることができ、世界的レベルでの競争力も強化できます。現実的には、そう簡単に話は進まないことが大宇自動車や現代電子の破綻が示しています。

今後韓国の財閥グループはどうなるのでしょうか。さらに主要財閥グループは成長して、市場の寡占化が進むのか、それとも日本が経験したようにいずれは解体するのでしょうか。

このニュースレターは韓国の財閥系企業で仕事をされている多くの人々にも届いているかと思います。皆様のご意見をいただければ幸いです。

沼倉研史
DKNリサーチ

今週のヘッドライン

1. ChipMOS (台湾の半導体組立てメーカー) 1 / 2 6

BGAパッケージ用のサブストレートの調達について、Ryowa社から1年間でDDR 用に3千万個の供給の契約。

2. IPC (米国) 1 / 2 6

12月の米国プリント基板業界のB/Bレシオは0.07ポイント下落して、1.06に。リジッド、フレキシブル基板のいずれも下がった。フレキシブル基板は0.95で、マイナス成長の局面に。

3. ASE (台湾のICサブストレートメーカー大手) 1 / 2 6

昨年の火災事故から、製造設備はほぼ復旧。第2四半期には、PBG A基板を34百万個/月の体制に。フリップチップは月産1~2百万個。

4. ホンハイ (台湾のEMS最大手) 1 / 2 7

2005年の売上げは1兆台湾ドル(310億米ドル)を達成。2兆台湾ドル達成は、当初の計画より速まり、2008年の可能性。

5. ヴェライゾン (米国電話通信最大手) 1 / 2 6

2005年第4四半期の利益は減少。先に行ったMCI社の買収の負担が大きく、今後3年間で7000人を削減するコストダウンの計画。

6. IDC (米国の市場調査会社) 1 / 2 7

2005年の世界の携帯電話の出荷は、前年比で16.7%の成長で、8億2550万台に達したと発表。トップのノキアのシェアは32.1%。

7. ディスプレイサーチ (米国の市場調査会社) 1 / 3 0

2005年第四半期の世界の液晶モニターの出荷は、前年同期比で68%の成長で、2840万台に達したと発表。米国デル社が17.1%のシェアでトップ。

8. ビショップ (米国の市場調査会社) 1 / 2 5

1 2月のコネクタ業界のB / Bレシオは1 . 0 1。受注額は前年同月比で1 4 . 5 %の増加。

9. サムスン電機 (韓国のプリント基板メーカー最大手) 1 / 3 1

2 0 0 6年は、前年比で1 0 %以上で、1兆ウォン越えの目標。日本のイビデンに次いで、世界で2番目の一をねらう。

1 0. サムスンSDI (韓国のディスプレイメーカー大手) 1 / 3 1

携帯オーディオ機器向けに小型の燃料電池を開発。1 . 5ワットの機器を4時間動かす能力。

1 1. クァンタム (米国のHDDメーカー大手) 1 / 3 1

2 0 0 6会計年度第3四半期、売上げは前年同期比で8 %増の2億1 8 0 0万ドル。昨年1月に買収したサータンス社の寄与が大きい。かろうじて黒字で、8 2万ドルの利益。

1 2. フレクストロニクス (シンガポールのEMS大手) 1 / 3 1

今年第1四半期に予定していた、ノルテル社のカルガリー事業所の移管を第2四半期に延期。

1 3. カムテック (イスラエルの検査機メーカー) 2 / 1

台湾の大手基板メーカーから、ICサブストレートの検査用に複数の高機能AOI装置を受注。総額1 9 0万ドル。

1 4. エルプリント (ヨーロッパの基板メーカー) 2 / 1

7 8 2万ユーロを投資して、工場の設備を一新。フレキシブル基板やリジッドフレックス用にLDI、プラズマエッチング装置も導入。

1 5. コーニング (米国のガラス材料メーカー大手) 2 / 1

TFT・LCD用のガラス基板の工場を中国に建設することを決定。現在数カ所の候補を調査中。

1 6. ローム&ハース (米国の基板用化学品大手) 2 / 2

2 0 0 5年の売上げは、前年比で1 0 %増の7 9億9 4百万ドル。利益は2 9 %増の6億3 8百万ドル。

1 7. アンフェノール (米国のコネクタメーカー) 2 / 1

高速通信用に、新たに2 5 G b / sのデータ通信対応のクロスポー (TM) シリーズを商品化。

18.SIA (米国の業界団体) 2 / 2

2005年の世界の半導体出荷額は2275億ドルとなり、前年比で6.8%の成長を達成し、新記録。

19.エルコテック (フィンランドのEMS大手) 2 / 2

2005年第4四半期の売上げは12億28百万ユーロ。利益は64%増の2390万ユーロに改善。2006年はさらに向上を見込む。

20.コーニング (米国のガラス材料メーカー大手) 2 / 2

韓国のサムスン電子と新たなJV、Samsung Corning Precision Glass Co., Ltd. を設立。韓国での液晶用ガラスサブストレートの供給を目指す。

21.MIC (台湾の市場調査機関) 2 / 1

2005年における台湾のマザーボードの出荷は、前年比で5.8%増の1億45百万セットに。

22.Simavelec (フランスの電子業界団体) 2 / 2

フランスの民生用電子機器市場は、今年6%の成長で62億ユーロに達すると予測。

23.Mフレックス (米国のフレキシブル基板最大手) 2 / 2

2006会計年度第1四半期、売上げは前年同期比で66%増の1億3970万ドル。利益は82%増の1730万ドル。

(注) このヘッドライン・ニュース・レターは速報性を重視するために、若干の誤訳や数字の変換に誤りがある場合もございます。ご了承下さい。

DKNリサーチ
栄泰産業株式会社

最近の興味深い文献から

Articles of DKN Research

1. “The Global Business Trends of the Flexible Circuits, Direction to the High-Density Advanced Flexible Circuits”, Dominique Numakura, KPCA Magazine, August, 2005 (Korean language)
2. 「よくわかるICパッケージのできるまで」沼倉研史&J. ヴァーダマン、日刊工業新聞社、2005年12月発行、1800円

“ Easy understanding Series, How to make IC packages ” , (Japanese only), Jan Vardaman & Dominique Numakura, Nikkan Kogyo Shinbun, December, 2005, 1800 yens.

3. 「先端実装インサイド、No. 10. 高密度実装への道(2) 新しいICパッケージ」沼倉研史、実装技術、2006年1月号

“ The latest semiconductor package, Part II ” , Dominique Numakura, Electronics Packaging Technology, December, 2005

4. 「高密度フレキシブル基板の最新技術動向」沼倉研史、電子材料7月号別冊、実装技術ガイドブック、2005

“ The Latest Technology Trends of the High Density Electronic Circuits ” , Dominique Numakura, Denshi Zairyo, the Special Edition of Jisso Guidebook, July, 2005

5. “ Technical Roadmap of High Density Interconnects with Flexible Substrates in Portable Electronics ” , Robert Turunen & Dominique Numakura, PCB Design Conference West, Mar. 10, 2005, Santa Clara

From the Major Industry Magazines

1. “ How to Design with Flex in Mind ” , Mark Finstad, CircuiTree January, 2005.

2. “ Surface Oxidation as a Tin Whisker Growth Mechanism ” , W. J. Wolfgang, B. Ogden, R. Champaign and B. Waller, Circuits Assembly, December, 2005.

3. “ PCB Contained? Try Flexing Your Circuits ” , Ian Gabbitas, SMT, December. 2005

4. “ Back to Basic ” Susy Webb, Printed Circuit Design & Manufacturing, January 2005.

5. “ Solder Bumping Single Die ” , Terence Q. Collier, Advanced Packaging, December, 2005